

フォトマスク

フォトマスクは、LSI など集積回路の製造工程で使用される部材です。表面の遮光膜に微細な回路パターンをエッチングした透明なガラス板です。



フォトマスク供給実績例

- 半導体用
- 光導波路、光デバイス用
- MEMS用
- レジスト評価用
- マイクロレンズ用
- 装置精度管理用
- アライナー用
- ステッパー用
- LED用
- 解像度評価用 など

データフォーマット

- MEBES
- JEOL
- MIC
- VSB
- Gerber
- GDS
- DXF
- DWG
- BMP

※ 上記以外のフォーマットはご相談ください。

対応可能サイズ

blanks size	thickness	material	film	film thickness	drawing area
152 × 152 mm (6 × 6 インチ)	6.35 mm (0.25インチ)	Qz	Cr	105nm	146 × 146 mm
		Qz	Cr	73nm	146 × 146 mm
		Qz	MoSi (KrF-PSM)	(透過率6%@KrF)	146 × 146 mm
		Qz	MoSi (ArF-PSM)	(透過率6%@ArF)	146 × 146 mm
	3.05 mm (0.12インチ)	Qz	Cr	105nm	146 × 146 mm
	2.30 mm (0.09インチ)	Qz	Cr	105nm	146 × 146 mm
127 × 127mm (5 × 5 インチ)	4.60 mm (0.18インチ)	Qz	Cr	105nm	120 × 120 mm
	2.30 mm (0.09インチ)	Qz	Cr	105nm	120 × 120 mm

Laser Beam Exposure

項目	規格
	Qz材
寸法精度	設計値 ± 0.025 um
トータルピッチ精度	設計値 ± 0.070 um
位置精度	設計値 ± 0.035 um
パターン欠陥	0.15 um 0個
最小寸法	Line パターン 0.7 um , Holeパターン 1.0 um

50kv Electron Beam Exposure

項目	規格
	Qz材
寸法精度	設計値 ± 0.015 um
トータルピッチ精度	設計値 ± 0.050 um
位置精度	設計値 ± 0.025 um
パターン欠陥	0.10 um 0個
最小寸法	Line パターン 0.4 um , Holeパターン 0.6 um

※ 上記以外の仕様はご相談ください。